

2液放熱ギャップフィラー

特長

- ・ 常温硬化または加熱硬化可能
- ・ 優れた界面濡れ性
- ・ 優れた耐候性
- ・ 保存の容易性



物性値

項目	SDG020	SDG040	SDG060	SDG080 開発品	SDG100 開発品	SDG120 開発品
硬化前の特性						
A/B外観	blue/yellow	Light gray/blue	Light red/Light gray	Red/Gray	Red/Gray	Red/Gray
混合後粘度 (Pa·s)	400	420	420	540	400	430
可使時間 (min)	60	60	120	120	60	120
BLT(μm)	150	150	160	200	200	200
硬化後の特性						
硬度 (Shore OO)	50	65	60	65	65	67
密度(g/cm ³)	2.6	3.1	3.3	3.3	3.1	3.2
体積抵抗率 (ohm·cm)	1*10 ¹²	1*10 ¹³	1*10 ¹²	1*10 ¹²	1*10 ¹²	1*10 ¹²
絶縁破壊強度 (kV/mm)	12	13	11	7	9	6
熱伝導率 (W/(m·K))	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
難燃性	V-0相当	V-0相当	V-0相当	V-0相当	V-0相当	V-0相当
使用温度範囲 (°C)	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180

*以上データが測定値であり、保証値ではありません

1液放熱グリス

特長

- ・ 低粘度で、ディスペンサ、スクリーン印刷など塗布方法に適用可能
- ・ 低熱抵抗、低揮発性
- ・ 無溶剤タイプ
- ・ 優れた絶縁性、耐候性
- ・ 優れた安定性



物性値

項目	SG010	SG020	SG030	SG031	SG060
外観	White	White	White	White	Gray
粘度 (Pa·s)	300	300	140	100	400
密度 (g/cm ³)	2.4	4.0	3.2	3.4	3.2
BLT (μm)	35	10	70	10	60
体積抵抗率 (ohm·cm)	1*10 ¹²				
絶縁破壊強度 (kV/mm)	6	6	5	5	5
熱抵抗値 (°C·cm ² /W)	0.248	0.100	0.220	0.060	0.140
熱伝導率 (W/(m·K))	1	2	3	3	6
使用温度範囲 (°C)	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180

*以上データが測定値であり、保証値ではありません

1液放熱ゲル

特長

- ・ 優れた界面濡れ性
- ・ 部品の経年劣化や膨張の緩和ができて
- ・ 自動化設備に適用
- ・ リワーク対応可能



物性値

項目	STG035	STG040	STG060	STG080 開発品	STG100 開発品	STG120 開発品
外観	Blue	Blue	Red	Blue	Light Gray	Light Gray
粘度 (Pa·s)	1500	1500	1200	1200	1400	1500
密度(g/cm ³)	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
BLT (μm)	80	150	150	200	200	200
体積抵抗率 (ohm·cm)	1*10 ¹²					
絶縁破壊強度 (kV/mm)	6	6	5	5	5	5
熱抵抗値 (°C·cm ² /W)	0.30	0.34	0.23	0.35	0.29	0.26
熱伝導率 (W/(m·K))	3.5	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
射出速度 (g/min)	65	25	16	18	16	16
使用温度範囲 (°C)	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180	-40~180

*以上データが測定値であり、保証値ではありません

ポッティング剤

特長

- ・ 低粘度で、加工性に優れる
- ・ 沈降にくいタイプ
- ・ 室温硬化または加熱硬化可能
- ・ 低収縮率、密着性に優れる
- ・ 絶縁性・防湿性、耐酸・耐アルカリ性



物性値

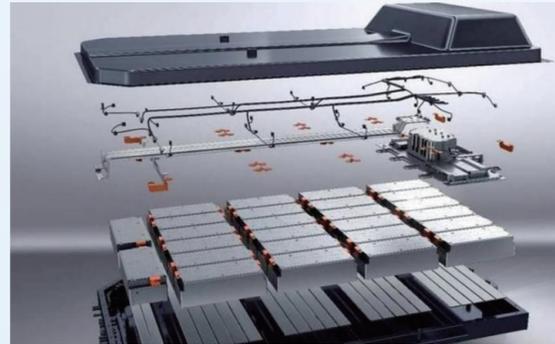
項目	粘度 (cps)	密度 (g/cm ³)	可使用時間 (min)	硬度 (Shore A)	体積混合比	熱伝導率 W/(m·K)	使用温度範囲℃
シリコン系							
SP009	1000-4000	1.6	30	35	1:1	1.0	-40~180
SP020	3000-6000	2.6	30	25	1:1	2.0	-40~180
SP030	7000-10000	3.0	30	25	1:1	3.0	-40~180
SP040	11000-15000	3.3	30	65 (00)	1:1	4.0	-40~180
SP001LD	1600-2600	0.6	14	35	1:1	-	-40~85
エポキシ系 (Shore D) 重量混合比							
ETP106	1000-3000	1.53	120	82	100:13	0.6	-40~125
ETP 310	4000-7000	1.60	180	87	1液型	1.0	-40~150
ETP510	6000-10000	2.11	240	90	1:1	1.0	-40~180
ETP520	9000-15000	2.85	240	92	1:1	2.0	-40~200
EP505	3000-8000	1.80	80℃ 1h + 120℃ 2h + 150℃ 2h	90	1液型	-	-40~230
EP560	6000-12000	1.08	120	70	2:1	-	-40~125
ハイブリッド (Shore A)							
HP130	5000-10000	0.99	UV+湿気硬化	25	1液型	-	-40~150

*以上データが測定値であり、保証値ではありません

構造用接着剤

特長

- ・ 高接着強度、高破断伸び率
- ・ 低圧縮力
- ・ 低粘度で塗布しやすく、設備の摩耗を軽減
- ・ 優れた耐候性



物性値

項目	粘度 (Pa·s)	密度 (g/cm ³)	可使用時間 (min)	硬度 (Shore D)	熱伝導率 W/m·K	せん断強度 (MPa)
ポリウレタン系						
UTB080	95	1.65	15	65	0.8	8
UTB120	150	1.77	15	60	1.2	10
UTB200	470	2.17	30	65	2.0	11
UTB300	220	2.65	25	60	3.0	3
UB232	-	1.41	20	70	-	12
UB249	130	1.55	15	65	-	15
エポキシ系 硬化時間						
EB316	150	1.48	40min @ 120℃	82	-	19
EB330	30-50	1.20	15min @ 155℃	85	-	25

*以上データが測定値であり、保証値ではありません

AA接着剤

特長

- ・ UV照射による急速仮硬化で位置固定
- ・ 一液型で自動ディスペンサーに適用
- ・ 多様な基材に対して優れた接着性を発揮
- ・ 優れた耐候性
- ・ 低収縮、低応力



物性値

項目	HA220	HA261	HA263	HA267
材料種類	シリコン	エポキシ	エポキシ	エポキシ
外観	偏黄/Clear	偏黄/Clear	偏黄/Clear	偏黄/Clear
硬化方式	UV+熱硬化	UV+熱硬化	UV+熱硬化	UV+熱硬化
UV硬化条件	3-6s @365nm 1000- 2000mW/cm ³	3-6s @365nm 500-2000mW/cm ³	3-6s @365nm 1000- 2000mW/cm ³	3-6s @365nm 200-2000mW/cm ³
熱硬化条件	60min @ 110℃	60min @ 110℃	60min @ 100	60min @ 85℃
粘度 (Pa·s)	100	10	18	20
チクソ指数	4.5	5	5	4
ガラス転移温度 (℃)	-40	30	125	160
熱膨張係数 (ppm/℃)	240	70	60	30
本体強度 (MPa)	3	6	-	-
硬化深度 (mm)	2	2	2	2
DIE Shear@Glass (MPa)	2.2 (Lap shear)	25	25	15 (PCB)
体積収縮率 (%)	-	2.0	2.0	1.4

*以上データが測定値であり、保証値ではありません